

山东天岳先进科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

公司自成立以来即专注于高品质碳化硅衬底的研发与产业化。公司是全球少数能够实现 8 英寸碳化硅衬底量产、率先实现 2 英寸到 8 英寸碳化硅衬底商业化的公司之一，也是率先推出 12 英寸碳化硅衬底的公司。

2025 年，全球能源变革与人工智能（AI）技术加速融合，推动功率半导体和新型半导体材料需求持续演进。碳化硅材料凭借高耐压、高频、高热导、高温稳定性等综合优势，正在成为绿色低碳与高效算力基础设施的重要材料支撑。伴随新能源汽车、电网与新能源绿电、储能升级、数据中心能效提升、工业与消费电子能效提升，以及光学与先进封装等新场景的发展，碳化硅下游应用由点到面扩展的趋势进一步清晰。

与此同时，2025 年行业竞争格局进一步优化，价格波动、产业规模提升与客户导入周期并存，行业处于从早期无序扩张向大尺寸化、规模化、成本优化和结构升级并行推进的重要阶段。公司在此背景下，坚持长期主义，围绕“市场份额提升”与“技术持续进步”两条主线推进经营，一方面抓住行业调整窗口，持续巩固与全球头部客户合作关系，另一方面通过大尺寸产品、工艺优化与应用拓展提升长期竞争壁垒。

从产业趋势看，2025 年已成为碳化硅进一步扩大规模化应用的重要一年。随着技术进步、单位成本下降以及头部企业规模增长，碳化硅在新能源汽车、数据中心、先进封装、微纳光学之外，以及更加广义的工业、电网、光伏、储能、充电设施、家电及消费电子等领域均表现出相较传统半导体材料的综合优势，应用渗透进入“规模化导入”阶段。公司围绕这一趋势，持续完善产品矩阵、加强客

户共研、推进大尺寸化与多元应用布局，力争在行业新一轮发展中占据更有利位置。公司也正从半导体器件材料供应商向更广泛的先进材料平台型企业延伸。同时，作为全球宽禁带半导体材料行业的领军企业，公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，持续优化内部生产管理、改进工艺技术、提升产品良率，坚持研发创新和市场拓展；同时，公司积极主动开源节流，合理管控成本费用，推进精益改善等一系列措施实现降本增效。

（一）公司经营情况

1、聚焦市场份额提升，逆势巩固行业领先地位

2025 年，公司将抢占市场份额作为核心经营策略之一，在行业承压背景下仍实现了份额提升。根据日本富士经济于 2026 年 3 月发布的报告测算，2025 年全球导电型碳化硅衬底材料市场中，天岳先进（SICC）市场份额为 27.6%，位居全球第一；其中 6 英寸市场份额为 27.5%，8 英寸市场份额为 51.3%，充分体现了公司战略执行的成果。

从经营逻辑看，行业下行阶段往往更能检验公司的真实竞争力。公司之所以能在 2025 年逆势实现份额增长，核心在于：一是前瞻布局 8 英寸和 12 英寸，把握了行业尺寸升级方向；二是客户合作深、认证壁垒高，在长周期验证体系下具有较强黏性；三是规模化交付与质量稳定性经过国际头部客户验证，能够在行业竞争中获得更多订单与导入机会。

报告期内，公司持续在产品品质、量产交付、技术迭代与客户协同上的加强投入，保持与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上厂商的业务合作关系，在行业下行周期中进一步扩大了优质客户覆盖范围，并持续开拓新领域、新客户、新应用。

通过前瞻性布局大尺寸产品，在行业从 6 英寸向 8 英寸加速切换过程中取得了明显优势，2025 年公司持续扩大 6 英寸市场份额，并在 8 英寸市场份额上占据头部位置。同时大尺寸产品占比提升，不仅帮助公司扩大了市场份额，也有助于改善产品结构、强化客户绑定并提升长期竞争壁垒。

2、深化头部客户合作，持续扩大客户版图

报告期内，公司与各行业头部客户的合作进一步深化，新能源汽车、数据中心、先进封装、微纳光学等领域的重点客户合作关系进一步加强，体现出公司在

产业链关键材料环节的综合竞争力。公司长期采取直销模式，依托销售、研发、生产联动机制，能够快速响应客户需求并参与客户前期验证、产品定义与工艺优化，从而增强合作深度和客户黏性。

在新能源汽车及功率器件领域，公司持续服务全球领先客户。公司已与全球前十大功率半导体器件制造商中一半以上建立合作关系，并与国际客户形成长期稳定合作生态。报告期内，行业大尺寸化的趋势进一步确定，随着公司大尺寸产品经济性持续加强，行业从 6 英寸向 8 英寸切换，公司通过大尺寸产品进一步加深与客户的合作关系；同时，由于碳化硅衬底作为器件制造关键材料，需要经过外延、芯片制造、封装测试等复杂验证程序，下游客户一旦完成验证通常不会轻易更换供应商，这使得公司在服务头部客户后具有较强持续供货优势。

报告期内，公司与下游客户持续推进各项技术合作。如在微纳光学领域，公司于 2025 年 7 月与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司达成战略合作，双方将整合碳化硅材料与光学技术优势，推动碳化硅衬底材料在光学领域应用，开拓新的蓝海市场。在 AI 数据中心供电方案中，公司配合全球头部功率器件厂商，就下一代电源管理芯片的研发展开密切合作。在先进封装领域，公司配合全球头部客户推进 SiC 的应用突破；同时，在芯片散热方向，公司目前已成功将半绝缘碳化硅衬底应用于高功率激光器芯片的散热层，并形成批量出货，验证了碳化硅散热在产业端规模化应用的可行性。这些合作不仅体现公司在新兴应用方向的前瞻布局，也标志着公司正从单一材料半导体器件材料供应商向更广泛的先进材料平台型企业延伸。

此外，公司在与重要合作伙伴关系上持续深化。如公司于 2025 年 10 月获得“博世全球供应商奖”，标志着双方产业链协同进入深度绑定阶段，与博世的长期战略合作伙伴关系进一步加深。这类合作关系的持续稳定，有利于公司在行业波动期保持订单韧性，并进一步提升全球影响力。

整体来说，公司深度融入碳化硅行业价值链，与上下游企业建立了紧密的合作生态。公司以先进的技术能力为核心，精准把握全球客户的最新需求，链接全球顶尖的供应链资源，不断推动大尺寸、高质量的碳化硅衬底产品在各领域的渗透率提升，并最终实现产业链共赢，持续提升全球影响力。

3、应用场景持续拓宽，碳化硅进入更广泛规模化应用阶段

2025 年，碳化硅应用从新能源汽车、光伏储能等传统高景气场景，进一步向 AI 数据中心、智能电网、先进封装、微纳光学、工业、充电设施、家电和更多消费电子场景延展。这一趋势的底层驱动在于，随着碳化硅材料和器件技术持续进步、尺寸升级、成本下降和规模效应显现，其相较传统硅基材料在低中高压、高频、高效率、高功率密度和热管理上高效性能正在被更多终端应用所接受。

在 AI 数据中心领域，随着 AI 算力快速增长，数据中心能耗与供电效率问题日益突出。根据弗若斯特沙利文资料，至 2030 年全球 AI 数据中心容量将增长至 299GW，较 2023 年净增加 244GW，2023 年至 2030 年复合年增长率达到 27.4%，数据中心耗电量占全球电力消费比例将由 1.4% 提升至 10.0%。碳化硅功率器件在数据中心电源、UPS、服务器电源等场景可实现更高转换效率与功率密度，因此对高品质碳化硅衬底的需求具有明确增量意义。

在 AI 眼镜-微纳光学领域，碳化硅材料凭借优异光学特性和轻量化潜力，正在成为重要的显示新材料。资料显示，至 2030 年全球 AI 眼镜出货量有望超过 6000 万副；公司 2025 年在该领域已形成实质性布局，不仅与舜宇奥来达成战略合作，还凭借“碳化硅光波导片在 AI 眼镜中的应用”方案入选中国信通院优秀案例，表明公司在碳化硅材料跨界应用方向已具备较强产业化落地能力。

在电网、工业、光伏储能、轨道交通和家电等领域，碳化硅优秀的材料特性带来的性能提升则更为明显。根据相关预测，2024 年至 2030 年，碳化硅功率半导体器件在光伏储能、电网、轨道交通等领域的复合增长率分别可达 27.2%、24.5%、25.3%。随着使用经济性不断提升，更多原本由传统硅基器件主导的场景开始引入碳化硅方案，推动行业由单一赛道增长向多场景共振演进。

4、引领尺寸升级趋势，推动行业由 6 英寸向 8 英寸切换并布局 12 英寸

报告期内，公司继续引领行业向大尺寸衬底升级，目前 6 英寸导电型衬底仍为主流、8 英寸导电型衬底正快速起量、12 英寸前瞻布局推进顺利。尤其是公司在 8 英寸导电型衬底的质量与批量供应能力处于全球领先地位，是全球少数能够批量出货 8 英寸碳化硅衬底的市场参与者之一，持续推动头部客户向 8 英寸转型。

8 英寸衬底的重要性在于，其更大的可用面积有助于提升单片晶圆产出、改善器件制造经济性并推动下游产线与设备兼容优化。同时，全球碳化硅功率器件制造商在 8 英寸项目上的总投资额持续提升，行业向 8 英寸切换已成为一个清晰

的趋势。

在更大尺寸布局方面，公司于 2024 年 11 月推出业内首款 12 英寸碳化硅衬底，并于 2025 年一季度完成 12 英寸导电 N 型、导电 P 型及半绝缘型全系列产品技术攻关。目前 12 英寸产品已获得头部客户订单，这意味着公司在下一代大尺寸衬底方向上已经走在行业前列。12 英寸的意义不只是技术展示，更在于 12 英寸的批量产出将使得诸多新兴领域成功落地，SiC 作为先进平台型材料进一步降低诸多领域的单位成本，并打开更大规模商业化空间。

从产业竞争角度看，谁能够率先完成从 6 英寸到 8 英寸，再向 12 英寸延伸的量产与客户导入，谁就更有机会在下一轮行业竞争中掌握主动权。报告期内公司在 8 英寸占比提升、12 英寸持续推进上的表现，体现了公司在技术路线选择—产能能力建设—客户验证推进等三方面的协调能力，也增强了未来盈利能力与市场份额继续提升的基础。

（二）研发创新情况

碳化硅衬底属于高度技术密集型行业，制备流程复杂、工艺壁垒高，核心竞争力很大程度上取决于材料基础研究、晶体生长、缺陷控制、加工工艺、设备设计和产业化协同能力。保持技术领先是公司的长期战略重点。2025 年，公司继续围绕基础研究、产品开发和工程优化开展持续投入，强化自主创新能力，推动技术进步与产业化能力相互促进。

2025 年公司研发费用为 1.66 亿元，较 2024 年增长 16.91%。研发投入增加主要用 12 英寸碳化硅衬底、8 英寸衬底产业化研发，P 型衬底以及光学、先进封装等新兴领域方向的开发。公司在行业景气承压阶段并未削弱研发投入，而是继续加大前瞻性技术和新应用方向布局，体现出较强的长期投入定力。

从技术方向看，公司持续围绕大尺寸化、低缺陷、低成本、液相法、P 型衬底以及新型应用材料等方向推进研发。公司业内首创使用液相法制备出无宏观缺陷的 8 英寸碳化硅衬底，突破了碳化硅单晶高质量生长界面控制和缺陷控制难题；同时，公司也是率先使用液相法生产 P 型碳化硅衬底的公司之一，这为智能电网、高压大功率器件等场景的拓展提供了技术支撑。

报告期内，公司围绕“销售—研发—生产”联动机制继续强化研发体系。公司与下游战略客户共同推进研发，痛点及需求开展针对性研发，并基于客户反馈

持续优化迭代产品，使研发成果能够更快转化为产业化能力和客户价值。对于碳化硅这类验证周期长、产业链协同要求高的材料行业而言，这一机制有利于公司在技术创新与市场拓展之间形成正循环。

从知识产权成果看，公司在持续研发投入基础上，已形成较为系统的知识产权积累和技术壁垒。截至 2025 年末，公司及下属子公司累计获得发明专利授权 203 项、实用新型专利授权 308 项，其中境外发明专利授权 14 项；报告期内新申请发明专利和实用新型专利等 64 项，其中发明专利 49 项、实用新型 13 项。

从人才与组织能力看，公司持续打造全球碳化硅人才高地。截至报告期末，公司研发人员中硕士、博士合计 67 人，占研发人员总数 37.43%；公司拥有 2 名享受国务院特殊津贴专家，并汇聚国家级人才 7 人、省级人才 12 人、市级人才 14 人。未来三年，我们将持续优化人才矩阵，进一步完善覆盖材料科学、电子工程、物理、化学、机械工程等多学科背景的研发团队，为公司在基础研究、产品开发和工程转化上的持续推进提供支撑。

2025 年，公司研发创新成果还在多项外部荣誉中得到体现。公司于 2025 年 5 月凭借“一种高平整度、低损伤大直径单晶碳化硅衬底”获得第二十五届中国专利银奖；2025 年 6 月获得日本权威半导体媒体颁发的“半导体电子材料”类金奖；2025 年 11 月因“全系列 12 英寸碳化硅衬底全球首发”入选“2025 年度中国第三代半导体技术十大进展”。这些成果从侧面体现了公司技术创新在国内外产业界的影响力。山东省科技进步特等奖

总体看，2025 年公司持续推进研发创新工作，坚持高强度投入，在行业波动中保持技术进步节奏不变；围绕大尺寸化与新应用方向进行前瞻布局，既服务当前市场份额提升，也服务未来产业升级；同时，公司强化研发成果向量产和客户价值转化，持续推动从技术突破到产业化竞争力的闭环形成。这些工作将对公司未来在 8 英寸进一步放量、12 英寸持续突破，以及绿色低碳应用、AI 数据中心、微纳光学、先进封装等新应用方向的拓展形成有力支撑。

（三）年度成果和荣誉

2025 年，公司在技术创新、品牌建设、ESG 管理、资本市场布局等方面收获多项荣誉，彰显了公司的行业影响力和综合实力，得到了产业界、资本市场和社会各界的广泛认可。

1、技术与品牌荣誉方面

公司凭借在衬底技术突破与量产应用上的显著成果，斩获多项高含金量奖项，其中核心荣誉实现重大突破：公司导电型碳化硅衬底获评“国家制造业单项冠军”，继半绝缘型碳化硅衬底已获此项殊荣后再添佳绩，成功成就行业首个“双料单项冠军”，充分彰显公司在碳化硅衬底核心领域的绝对领先地位；凭借“高品质碳化硅单晶衬底产业化制备关键技术及应用”相关成果，荣获山东省科技进步特等奖，该奖项作为山东省科技领域最高荣誉之一，充分肯定了公司在碳化硅技术产业化落地、推动区域半导体产业高质量发展中的突出贡献；荣获国家知识产权局颁发的“中国专利奖（银奖）”，该奖项是中国知识产权领域的最高政府奖项，竞争极为激烈，充分彰显公司雄厚的技术研发实力与高价值专利培育能力；凭借“全系列 12 英寸碳化硅衬底全球首发”成果，入选“2025 年度中国第三代半导体技术十大进展”，彰显在大尺寸衬底领域的全球引领地位；荣获中国电子材料行业协会半导体材料分会颁发的“半导体材料行业突出贡献奖”，肯定了公司在技术研发、国产化替代方面的突破性贡献；凭借“高品质碳化硅单晶衬底产业化制备关键技术及应用”项目，荣获“国际发明展览会银奖”，体现公司技术创新的国际影响力；同时，公司获评“山东省先进级（省级）智能工厂”，彰显智能制造领域的标杆水平，以及“山东省新材料领军培育企业”“济南市服务产业链发展优质链主企业”，凸显在区域产业发展中的核心引领作用。此外，公司此前获得的“2025 行家极光奖”之“全球 SiC 衬底影响力企业”及“2025 年度优秀产品奖”，进一步巩固了其行业引领地位。

2、ESG 与规范经营方面

公司凭借系统化的 ESG 管理体系与扎实的可持续发展实践，荣获 2025 年度上市公司最佳 ESG 实践奖，体现了公司在环境、社会和治理方面的卓越表现；公司始终保持高水平的信息披露质量，持续提升规范运作水平和投资者关系管理质量，不仅树立了科创板上市公司规范经营的良好标杆，更以符合国际资本市场的合规运营标准，为本次港股成功上市奠定了坚实基础，也为国产碳化硅企业对接全球资本树立了合规典范。同时，公司获评“济南市工业节水示范企业”，积极践行黄河流域生态保护战略，彰显绿色发展理念。

3、产业影响力与国际认可度方面

公司碳化硅材料成功入选中国制造“十四五”成就展，登陆国家博物馆，彰显了公司的硬核科技实力，也体现了国家对碳化硅产业及公司发展的高度认可；公司作为国内碳化硅衬底行业的领军企业，积极协办全国半导体材料标准化分技术委员会相关会议，助力行业标准完善，推动产业高质量发展。在国际领域，公司斩获德国博世集团“卓越供应商”奖项，成为其全球约3.5万家供应商中获评的49家企业之一，彰显产品品质与供应能力的国际认可；同时，作为31年来首家荣获日本器件产业新闻第31届半导体年度奖“半导体电子材料”类金奖的中国企业，跻身全球顶尖半导体材料企业行列，标志着中国碳化硅产业整体实力的跃升。

4、资本市场方面

公司8月成功实现港股上市，成为国内碳化硅衬底领域首家“A+H”两地上市企业，这一资本布局的重大突破，不仅让公司迈入“A+H”双资本平台发展的全新阶段，更成为国产第三代半导体硬科技企业对接全球资本、实现国际化发展的标杆案例，充分印证了公司核心技术实力与全球化发展潜力获得国际资本市场的高度认可；同时公司凭借突出的科技创新实力与全球化发展布局，荣获“金牛上市公司科创奖（新材料）”“2025年度科技创新金牛奖（港股）”“2025硬科技突破奖”，资本市场认可度持续攀升。此外，公司研发团队获评“团省委在青春建功高质量发展工作中表现突出青年集体”，彰显了人才队伍建设的显著成效。

二、董事会履职情况

1、董事会会议召开情况

公司全体董事恪尽职守，忠实勤勉地履行职责。2025年，董事会共召开9次会议，公司全体董事均出席各次会议，会议的召集和召开程序、表决程序等事项均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第十次会议	2025年1月27日	审议通过如下议案： 1、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案 2、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 3、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			<p>4、关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案</p> <p>5、关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案</p> <p>6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案</p> <p>7、关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案</p> <p>8、关于变更公司董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的议案</p> <p>9、关于确定公司董事角色的议案</p> <p>10、关于聘任联席公司秘书及委任授权代表的议案</p> <p>11、关于批准公司注册为非香港公司的议案</p> <p>12、关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案</p> <p>13、关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案</p> <p>13.1 公司章程(草案)</p> <p>13.2 股东会议事规则(草案)</p> <p>13.3 董事会议事规则(草案)</p> <p>14、关于制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》的议案</p> <p>14.1 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度</p> <p>15、关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案</p> <p>15.1 提名委员会工作细则(草案)</p> <p>15.2 审计委员会工作细则(草案)</p> <p>15.3 薪酬与考核委员会工作细则(草案)</p> <p>15.4 战略委员会工作细则(草案)</p> <p>15.5 独立董事制度(草案)</p> <p>15.6 关联(连)交易决策制度(草案)</p> <p>15.7 信息披露管理制度(草案)</p> <p>15.8 募集资金管理制度(草案)</p> <p>15.9 股东通讯政策(草案)</p> <p>15.10 内幕信息知情人登记管理制度(草案)</p> <p>15.11 董事、监事及相关人员证券交易及披露管理办法(草案)</p> <p>15.12 董事会成员及雇员多元化政策(草案)</p> <p>16、关于对全资子公司增资的议案</p> <p>17、关于召开公司股东大会的议案</p>
2	第二届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 27 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案</p> <p>2、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案</p> <p>3、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案</p> <p>4、关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案</p> <p>5、关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>6、关于公司 2025 年度申请授信额度预计的议案</p>

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			7、关于公司 2025 年度担保额度预计的议案 8、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 9、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 10、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 11、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 12、关于开展外汇衍生品交易业务的议案 13、关于独立董事独立性情况专项意见的议案 14、关于 2024 年度环境、社会及管治报告的议案 15、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案 16、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案 17、关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 18、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 19、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 20、关于公司 2025 年度提质增效重回行动方案的议案 21、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 22、关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案 23、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 24、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案 25、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 26、关于召开 2024 年年度股东大会的议案
3	第二届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 29 日	审议通过如下议案： 1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案 2、关于公司变更会计政策的议案 3、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 4、关于调整董事会专门委员会成员的议案
4	第二届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 16 日	审议通过如下议案： 1、关于补选第二届董事会非独立董事的议案 2、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案
5	第二届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 6 日	审议通过如下议案： 1、关于确认 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案 2、关于修订《公司章程（草案）》的议案 2.1 公司章程（草案）-英文版 2.2 公司章程（草案）-中文版
6	第二届董事会第十五次会议	2025 年 8 月 29 日	审议通过如下议案： 1、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 3、关于 2025 年度提质增效重回行动方案的半年度评估报告的议案 4、关于作废处理部分限制性股票的议案

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			5、关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案
7	第二届董事会第十六次会议	2025 年 10 月 14 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案</p> <p>1.1 公司章程</p> <p>1.2 股东会议事规则</p> <p>1.3 董事会议事规则</p> <p>2、关于制定及修订公司部分治理制度的议案</p> <p>2.1 对外担保管理制度</p> <p>2.2 对外投资管理制度</p> <p>2.3 关联（连）交易决策制度</p> <p>2.4 独立董事制度</p> <p>2.5 募集资金管理制度</p> <p>2.6 投资者关系管理制度</p> <p>2.7 控股股东和实际控制人行为规范</p> <p>2.8 信息披露管理制度</p> <p>2.9 董事、高级管理人员薪酬管理制度</p> <p>2.10 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度</p> <p>2.11 提名委员会工作细则</p> <p>2.12 审计委员会工作细则</p> <p>2.13 薪酬与考核委员会工作细则</p> <p>2.14 战略与可持续发展委员会工作细则</p> <p>2.15 股东通讯政策</p> <p>2.16 内幕信息知情人登记管理制度</p> <p>2.17 董事及相关人员证券交易及披露管理办法</p> <p>2.18 董事会秘书工作细则</p> <p>2.19 总经理工作细则</p> <p>2.20 内部审计制度</p> <p>2.21 信息披露暂缓与豁免事项管理制度</p> <p>2.22 重大信息内部收集报告制度</p> <p>2.23 会计师事务所选聘制度</p> <p>2.24 控股子公司管理制度</p> <p>2.25 外汇衍生品交易业务管理制度</p> <p>2.26 董事、高管离职管理制度</p> <p>3、关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案</p> <p>3.1 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告</p> <p>4、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案</p>
8	第二届董事会第十七次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p>
9	第二届董事会第十八次会议	2025 年 12 月 30 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>2、关于公司 2026 年度申请授信额度预计的议案</p>

2、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

3、董事参加股东会的情况

2025年度，公司共召开4次股东（大）会，其中召开了1次年度股东（大）会。公司董事会提交股东（大）会审议的全部议案均获得股东（大）会审议通过。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东（大）会合规有序；认真贯彻执行股东（大）会的各项决议，组织实施股东（大）会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照相应的议事规则运作，就公司经营重要事项进行了研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

1、审计委员会工作情况

审计委员会本着勤勉尽职的原则，负责监督及评估外部审计机构工作、监督、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等，有效履行了职能。公司审计委员会由3名委员组成，均为公司董事。报告期内，审计委员会共召开5次会议，对H股发行上市聘请审计机构、定期报告、募集资金存放与使用情况等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬规划、考核标准，激励方案的规划和研究以及公司股权激励计划草案、考核管理办法、激励对象条件以及向激励对象首次授予限制性股票等。公司薪酬与考核委员会由3名委员组成，包含2名独立董事。报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，审议了2024年限制性股票激励计划相关事项，以及董事、高级管理人员的薪酬

方案。

3、提名委员会工作情况

提名委员会主要职责包括就董事、高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议、搜寻合格的董事和高级管理人员的人选、对董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议等。公司提名委员会由3名委员组成，包含2名独立董事。报告期内，提名委员会召开2次会议，对变更公司董事、补选非独立董事、聘任联席公司秘书及委任授权代表相关事项进行了审议。

4、战略与可持续发展委员会工作情况

战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议，包括对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议、对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议等。公司战略与可持续发展委员会由3名委员组成，包含1名独立董事。报告期内，战略与可持续发展委员会共召开2次会议，对发行H股上市及上市方案、境外募集资金、境外公开发行募集资金使用计划、2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2024年年报以及2024年度ESG报告等事项进行了审议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

五、公司信息披露及担保核查情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《对外担保管理制度》等相关规定对公司全部担保行为进行核查。经核查，2025年度公司不存在违规担保的行为，相关担保行为均已履行了相关审议程序与披露义务。

六、2026年度工作计划

2026年天岳先进将继续以“成为国际著名的半导体材料公司”为战略目标，立足新能源和AI引领未来科技革命的契机，始终秉持“先进品质持续”的经营理念，引领行业和技术发展，以高品质产品为客户创造更大的价值。

2026年，公司将继续围绕以下重点工作，推动天岳先进高质量发展，提升公司长期投资价值。

1、坚持主业聚焦，稳步提升大尺寸产能与有效利用率

公司将继续以碳化硅衬底主业为核心，围绕济南与上海临港两大基地，系统梳理并优化现有6/8英寸产线的产能结构与排产节奏，并审慎推进资本开支，稳步提升有效产能利用率与交付能力，并通过工艺优化、瓶颈环节扩能与智能排产等方式，提升整体产出效率，保障客户供货稳定性。

2、深化8英寸主流化应用，前瞻推进12英寸全系列产业化

公司将继续以“8英寸绝对领先、全球头部客户首选供应商、大尺寸高质量衬底量产标杆”作为年度经营重点。在8英寸方面，公司计划在2026年继续推进8英寸产品占比：一方面通过进一步提升8英寸良率和稳定性，巩固其在公司收入中的主力地位，另一方面加快更多车规级及工业客户的量产导入节奏。在12英寸方面，将围绕已完成的导电N型、P型及高纯半绝缘型全系列产品技术

攻关，重点推进与头部客户的合作，为即将到来的具备规模化交付条件时的快速产业化奠定基础。

3、构筑基于高品质和高质量服务的品牌力，维护行业健康利润率

2026年，公司计划以高品质产品和高质量服务为基底构筑品牌力，构筑以技术和服务质量为锚的盈利修复路径，维护行业健康利润率。公司将坚持价值定价，综合产品尺寸、质量、服务内容与长期战略保供能力，与客户建立以性能与可靠性为基础的长期合作关系，杜绝内卷式的价格博弈，重视客户满意度、良率与交付时效，并通过工艺进步和精益制造确保降本增效工作的顺利展开，并以内生性盈利支撑持续研发和智能工厂迭代投入，有力提升经营质量。

4、围绕“AI+新能源”双轮驱动，系统优化产品与市场结构

公司将围绕“新能源+AI”双主线下优化资源配置。一方面，继续深耕新能源汽车、光伏储能、电网及工业等传统高景气赛道，保障车规级6/8英寸导电型衬底稳定供货，支撑下游xEV领域碳化硅渗透率快速提升。另一方面，重点面向AI数据中心电源、先进封装散热与AI/AR眼镜光波导片等新应用领域，完善导电性衬底、光学级衬底及先进封装材料等产品线布局，强化与电力电子、AI智算、光学头部客户的联合开发，提升非车载业务在收入中的占比，以多场景、高门槛应用提升整体毛利和品牌高度，提升盈利弹性。

5、强化降本增效与精益制造，夯实成本优势

在行业竞争走向新阶段的背景下，公司计划进一步加强成本与效率管理。2026年，公司将继续围绕长晶质量提升、低缺陷生产、智能排产等环节深挖潜力，有效降低单位成本；同时，依托AI+智能制造管理体系，对长晶、切片、磨抛、清洗全流程进行更细颗粒度的监控和参数优化，减少人力成本、提高良率与一致性；此外，公司将在采购端推进多元化供应体系，平滑原材料价格波动。经营层面将围绕单位成本、单位能耗、单位人效等核心指标设定阶段性目标，以在竞争中保持合理毛利。

6、巩固并拓展全球头部客户生态，提升“A+H”平台下的国际化运营能力

公司将继续绑定关键客户，服务多元终端赛道。一方面，稳固与全球头部功率半导体龙头厂商的长期合作，通过满足其连续迭代的产品规格要求，确保在其全球供应链中的核心地位；另一方面，加快与AI数据中心、电网、微纳光学、

先进封装等领域头部客户的联合开发与产业化推进节奏，推动更多新应用项目进入批量出货阶段。依托 2025 年 H 股上市形成的“A+H”双融资与双品牌平台，公司将同步完善境外销售和技术支持网络，提升跨区域交付、结算与合规能力，为后续海外产能布局和更大规模出海打好基础。

7、持续加大研发投入与人才建设，强化“技术+知识产权”双重护城河

在 2025 年研发费用已达 1.66 亿元、同比增长 16.91%的基础上，公司计划继续保持研发投入强度，将资金重点用于 12 英寸、液相法 P 型衬底、面向电力电子领域新应用方向的各类导电性衬底、光学衬底、先进封装散热材料与射频等新材料方向。同时，继续推进在研项目落地，提升从基础研究，到产品开发、工程化试验，再到规模量产的转化效率。人才方面，公司将通过激励措施、科研平台与国际合作吸引和稳定高层次人才，为公司在未来行业技术拐点与应用切换中保持长期竞争力提供保障。

2026 年，公司董事会将根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的要求，以公司战略发展规划为指引，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，全面提升企业管理水平，加大科技创新和研发力度，进一步拓展产品应用领域，大力开拓新兴市场，提升企业综合竞争力，并与投资者共享公司发展成果，争取以良好的业绩回报广大投资者。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日